

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2002-188609
起案日	平成16年12月20日
特許庁審査官	大仲 雅人 8306 2P00
特許出願人代理人	上柳 雅誉 (外 2名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、または、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献については引用文献等一覧参照)

請求項1～8、10について

引用文献1 (密閉部材により密閉空間を形成する構成: 特に段落【0021】から【0022】および図1、2参照)。

引用文献2 (ヘッドフレームに対して制御基板が密閉状態で図示されている構成: 特に段落【0013】および図1、2参照)。

引用文献3 (キャップ部材、モールド剤による密閉空間の形成: 特に段落【0054】から【0055】、【0069】および図1、2、8参照)。

引用文献4 (弾性体からなる接合部材の構成: 特に段落【0011】および図1参照)。

請求項1、2に係る発明は、引用文献1又は2に記載された発明、或いは引用文献1又は2に記載された発明と引用文献3又は4に記載された密閉形成の発明に基づいて、当業者が容易に発明することができるものである。

請求項3乃至7に記載された従属的事項は、気密保持部材として、当業者が容易に考えられる設計上の問題であると解される。

請求項 9

引用文献 5（封止樹脂によるスルーホールの封止により密閉空間を形成する構成：特に段落【0016】および図1参照）。

（なお、明細書又は図面の補正に際しては、意見書においてその補正の根拠を明示されたい。）

引用文献等一覧

1. 特開2002-086713号公報
2. 特開平05-212860号公報
3. 特開平10-305578号公報
4. 特開平09-085945号公報
5. 特開平10-107397号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 B41J 2/045、B41J 2/055

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関して不明な点がありましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第一部 印刷・プリンター TEL. 03(3581)1101 内線3259